

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-04

| | |
|-----------------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>券商策略会</u> ） |
| 活动参与人员（排名不分先后） | 银华基金、富国基金、永赢基金、景顺长城基金、兴证全球基金、太平资产、泰康资产、博时基金、诺安基金、汇添富基金 |
| 上市公司接待人员 | 战略发展部总监、证券事务代表：谢丹 |
| 时间 | 2026年3月17日-20日 |
| 地点 | 电话及网络会议、机构投资者所在地、华创证券策略会 |
| 形式 | 电话及网络会议、实地调研 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司 2025 年年度经营业绩情况。</p> <p>2025 年，公司把握 AI 算力升级、存储市场需求增长、汽车电动智能化三大增长机遇，通过强化市场开发力度、提升市场竞争力，推动产品结构优化。同时，深入推进数字化转型与智能制造升级，提升运营管理能力，实现营收和利润同比增长。</p> <p>报告期内，公司实现营业总收入 236.47 亿元，同比增长 32.05%；归属于上市公司股东的净利润 32.76 亿元，同比增长 74.47%。其中，PCB 业务实现主营业务收入 143.59 亿元，同比增长 36.84%，占公司营业总收入的 60.73%；毛利率 35.53%，同比增加 3.91 个百分点。封装基板业务实现主营业务收入 41.48 亿元，同比增长 30.80%，占公司营业总收入的 17.54%；毛利率 22.58%，同比增加 4.43 个百分点。电子装联业务实现主营业务收入 30.75 亿元，同比增长 8.93%，占公司营业总收入的 13.00%；毛利率 15.00%，同比增加 0.60 个百分点。</p> <p>Q2、请介绍 2025 年公司 PCB 业务营业收入及毛利率变动原因。</p> |

2025 年，公司 PCB 业务实现主营业务收入 143.59 亿元，同比增长 36.84%，占公司营业总收入的 60.73%；毛利率 35.53%，同比增加 3.91 个百分点。PCB 业务受益于 AI 加速卡、服务器及相关配套产品需求加速释放，数据中心领域订单同比显著增加；高速交换机、光模块需求显著增长，有线通信相关产品占比持续提升；同时把握 ADAS 和新能源汽车三电系统的增长机会，汽车电子领域收入快速增长。在上述因素的作用下，公司营收规模增加、产能利用率提升、产品结构优化，带动 PCB 业务毛利率上行。

Q3、请介绍 2025 年公司封装基板业务营业收入及毛利率变动原因。

2025 年，公司封装基板业务实现主营业务收入 41.48 亿元，同比增长 30.80%，占公司营业总收入的 17.54%；毛利率 22.58%，同比增加 4.43 个百分点。封装基板技术能力持续突破，产品与客户导入进程加速，订单同比快速增长。受益于存储类、处理器芯片类基板需求拉动，存储类基板占比增加，产能利用率提升，叠加广州工厂爬坡顺利，助益封装基板业务毛利率改善。

Q4、请介绍 2025 年公司电子装联业务在下游市场拓展情况。

2025 年，公司电子装联业务实现主营业务收入 30.75 亿元，同比增长 8.93%，占公司营业总收入的 13.00%；毛利率 15.00%，同比增加 0.60 个百分点。

公司电子装联产品按照产品形态可分为 PCBA 板级、功能性模块、整机产品/系统总装等，业务主要聚焦通信、数据中心、医疗电子、汽车电子等领域。2025 年，公司电子装联业务充分把握数据中心及汽车电子领域需求的增长机会，深化客户战略协同，积极推进客户关键项目，强化专业产品线竞争力建设，带动相关业务营收稳步增长。

Q5、请介绍公司近期产能利用率情况。

公司 PCB 业务受益于 AI 算力基础设施硬件相关产品需求的增长，工厂产能利用率维持高位；封装基板业务因存储类、处理器芯片类基板需求拉动，工厂产能利用率延续 2025 年四季度以来的较高水平。

Q6、请介绍 PCB 工厂产能建设情况。

公司 PCB 业务在深圳、无锡、南通及泰国均布局生产基地，其中泰国工厂与南通四期

| | |
|-----------------------------|---|
| | <p>项目已于 2025 年下半年顺利连线投产，目前产能正稳步爬坡。此外，公司也在持续开展技改，并将根据市场情况，适时推进新项目论证和建设。</p> <p>Q7、请介绍公司广州封装基板项目爬坡进展。</p> <p>2025 年以来，公司广州封装基板项目产品线能力持续提升，其中 BT 类封装基板产能爬坡稳步推进，FC-BGA 类封装基板已实现 22 层及以下产品量产，24 层及以上产品技术研发及打样工作按期推进。2025 年广州广芯亏损同比缩窄。</p> <p>Q8、请介绍原材料价格变化情况及对公司的影响。</p> <p>公司主要原物料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多。2025 年，受大宗商品价格变化影响，铜箔、金盐等关键原材料价格同步上行，对公司盈利水平构成一定影响。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。</p> |
| <p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p> | <p>调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p> |
| <p>附件清单</p> | <p>无</p> |